

半導体試作ソリューション

ご仕様に合わせ、最適な材料・プロセスを選択。少量からの微細パターン加工に対応します。



基板手配

シリコン、ガラス、樹脂など**多様な材料**に対応



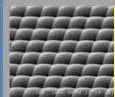
成膜

スパッタ、蒸着、CVD、メッキなど、**常時120種類以上の材料**を保有し、スピーディな対応が可能



イオン注入

イオン注入可能な材料は、**60種類以上**



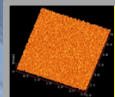
リソグラフィ

コンタクトアライナー、ステッパー、EB描画、
ナノインプリント、3Dパターンなど



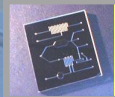
エッチング

ドライ(RIE、ICP)、ウェット、犠牲層エッチング



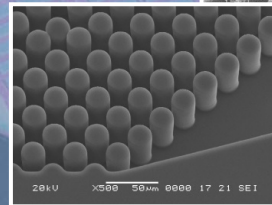
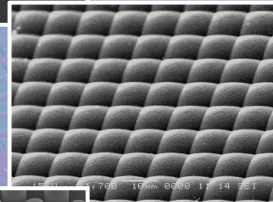
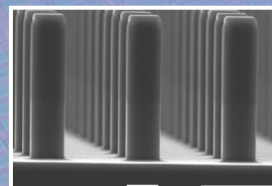
CMP

MEMS材料・構造に最適なCMPプロセスを、
スラリーの組成レベルから提案



ウェハ接合

表面活性化、ハイブリッド、陽極、共晶 etc.



<https://www.kyodo-inc.co.jp/electronics/>

044-852-7575 (電子部)